

铌酸锂晶片激光切割硅片异形加工晶圆精密打孔开槽个性定制

产品名称	铌酸锂晶片激光切割硅片异形加工晶圆精密打孔开槽个性定制
公司名称	北京华诺恒宇光能科技有限公司
价格	50.00/件
规格参数	品牌:华诺激光 加工方式:激光切割加工 加工材质:半导体材料、硅片、晶圆
公司地址	北京市丰台区南三环西路88号花卉研究中心2102号
联系电话	13011886131

产品详情

铌酸锂晶片激光切割硅片异形加工晶圆精密打孔开槽个性定制

激光切割技术具有切割质量好,切割速度快等优点.晶圆切割质量和提高切割速度为目的的几类整形激光切割技术,包括微水导激光切割技术,隐形切割技术,多焦点光束切割,"线聚焦"切割,平顶光束切割和多光束切割等.